

# 半导体

## 高景气下扩产行情持续，多家公司 H1 业绩亮眼

### 本周行情概览：

**本周半导体行情跑输主要指数。**本周申万半导体行业指数上涨 1.41%，同期创业板指数上涨 2.01%，上证综指上涨 2.77%，深证综指上涨 1.29%，中小板指上涨 2.35%，万得全 A 上涨 2.44%。半导体行业指数显著跑输主要指数。**半导体设备涨幅居前，一如我们此前的判断。**半导体细分板块中，半导体设备板块本周上涨 6.1%，半导体材料板块本周上涨 5.2%，IC 设计板块本周上涨 0.5%，分立器件板块本周下跌 0.1%，半导体制造板块本周下跌 1.2%，其他板块本周下跌 2.3%，封测板块本周下跌 2.5%。

**代工厂芯片涨价延续，以台积电为首的多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，扩产行情持续。**2020 年 Q3 以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至今，台积电 8 月 24 日先行向联发科、瑞昱与联咏等多家客户告知 16 奈米以上制程将全面大涨 20%，12 月新单将正式生效，也就是目前所谈定的 11 月订单全部收完后，12 月晶圆产出(wafer out)正式起涨。此外，联电、中芯、GlobalFoundries(GF)、世界先进、力积电与华虹等多家晶圆代工厂宣布涨价。

**扩产周期向上，持续看好国产半导体设备材料的机会。**半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达 53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030 大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，我们判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。

**东南亚疫情尚未控制，MOSFET、封测产能紧缺进一步增加，国内相关企业受惠于价格续涨及转单效应将更为明确。**东南亚新冠肺炎疫情蔓延，MOSFET 恐因产能排挤而缺货到明年，汽车行业尤为显著。闻泰科技、士兰微等相关龙头企业高景气度下优化产品结构，着重发展高利润汽车应用高压 MOSFET，毛利率持续提升。“半导体封测重镇”马来西亚疫情反弹，芯片交货时间再度延长。马来西亚疫情预期转单回大陆，国内封测龙头成为潜在受益标的。我国封测龙头长电科技、通富微电等目前产能较满，逻辑上利好，转单回大陆后可能会导致以上公司再发涨价函。

**财报季来临，多家公司 2021H1 业绩亮眼，看好高景气度下全年业绩持续超预期。**举例来看，**设备材料板块：**上海新阳净利润同比增长 316.82%，中微公司净利润同比增长 233.17%，精测电子净利润同比增加 203.43%，有研新材净利润同比增加 113.57%，华峰测控净利润同比增加 66.02%，北方华创预告净利润同比增长 50-80%，雅克科技净利润同比增加 14.72%；**功率器件板块：**士兰微净利润同比增长 1306.52%，闻泰科技半导体板块净利润同比增长 234.52%，新洁能净利润同比增长 215.29%，华润微净利润同比增长 164.86%；**封测板块：**长电科技净利润同比增长 260.97%，气派科技净利润同比增长 150.56%，晶方科技净利润同比增长 71.66%，利扬芯片净利润同比增加 47.1%。

### 建议关注：

IDM: 闻泰科技/三安光电；

半导体设备材料：北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微/ASM pacific；

半导体制造封测：中芯国际/华虹半导体/闻泰科技/三安光电/华润微/士兰微/长电科技/通富微电；

半导体设计：晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/芯朋微/斯达半导/新洁能/澜起科技/紫光国微/复旦微电/汇顶科技/上海贝岭；

**风险提示：**疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期

证券研究报告

2021 年 08 月 29 日

投资评级

行业评级

上次评级

强于大市(维持评级)

强于大市

作者

潘暕

SAC 执业证书编号：S1110517070005  
panjian@tfzq.com

骆奕扬

SAC 执业证书编号：S1110521050001  
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

联系人  
chengruying@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 《半导体-行业研究周报:本土 FPGA 板块有望迎来戴维斯双击》 2021-08-24
- 《半导体-行业研究周报:存储技术持续升级迭代，不改长期向上趋势》 2021-08-15
- 《半导体-行业研究周报:海外半导体业绩指引高景气，持续看好代工厂估值修复机遇》 2021-08-07

## 内容目录

1. 天风半导体每周谈：高景气下扩产行情持续，多家公司 H1 业绩亮眼.....	3
1.1. 芯片涨价延续，多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，持续看好扩厂周期下设备材料机会 .....	3
1.2. 东南亚疫情尚未控制，MOSFET、封测产能紧缺进一步增加 .....	6
2. 周观点 .....	8
3. 本周半导体行情回顾 .....	8
4. 本周重点公司公告 .....	10
5. 本周半导体重点新闻 .....	20
5.1. IC 设计 .....	20
5.2. 设备/材料 .....	21
5.3. 代工/封测 .....	21
5.4. EDA/IP/其他 .....	22
6. 风险提示： .....	23

## 1. 天风半导体每周谈：高景气下扩产行情持续，多家公司 H1 业绩亮眼

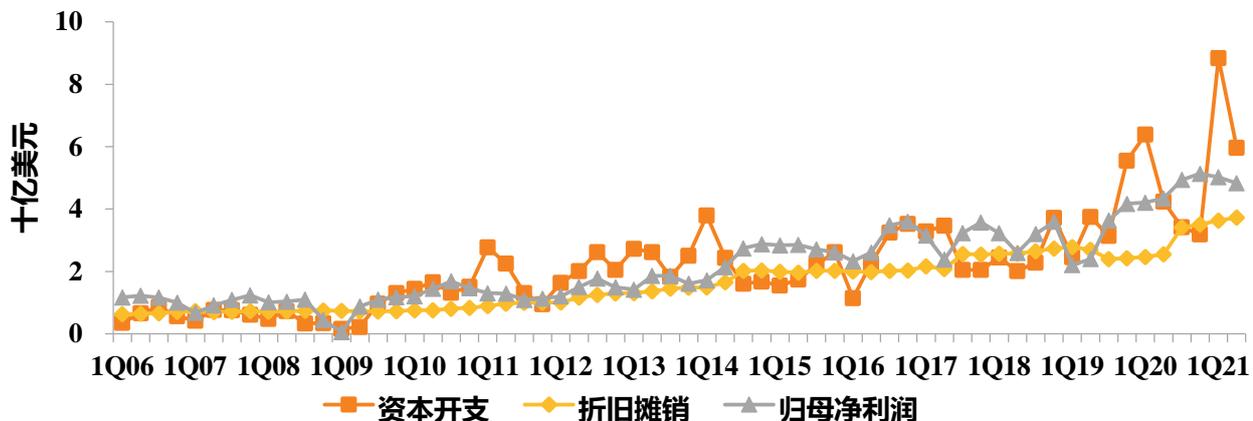
### 1.1. 芯片涨价延续，多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，持续看好扩产周期下设备材料机会

**芯片涨价延续，近期以台积电为首的多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价。**2020 年 Q3 以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至今，台积电 8 月 24 日先行向联发科、瑞昱与联咏等多家客户告知 16 奈米以上制程将全面大涨 20%，12 月新单将正式生效，也就是目前所谈定的 11 月订单全部收完后，12 月晶圆产出(wafer out)正式起涨。此外，联电、中芯、GlobalFoundries(GF)、世界先进、力积电与华虹等多家晶圆代工厂宣布涨价。

**Fab 看好行业景气度，持续加大投资力度。**据 Counterpoint 预测，半导体行业多个下游应用需求高涨，芯片市场仍将维持供不应求的状况，推动 2022 年芯片价格至少再涨 10-20%。以国际代表的晶圆厂台积电为例：2020 年在中国台湾台南新建晶圆厂，用于 5nm 制程和 3nm 制程的扩产；2021 年宣布将在亚利桑那州新建一座中型 5nm 晶圆厂，并计划于 2024 年投产。

**台积电进一步加大资本开支，全年资本开支预算维持 300 亿美元：**2021 年初曾宣布年资本支出为 250~280 亿美元，Q2 再调高至 300 亿美元，最高上调幅度达 20%；2021 年 4 月，宣布未来三年内将斥资 1000 亿美元扩张产能。同时，包括联电、中芯国际、华宏在内的多家厂商纷纷布局产能扩张，有望收益涨价周期。

图 1：台积电二季度资本开支 59.7 亿美元，持续高于当季归母净利润



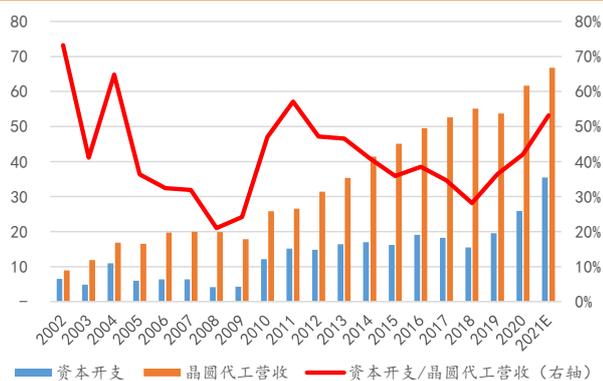
资料来源：公司公告，公司官网，天风证券研究所

**半导体扩产周期持续上行：**全球晶圆代工资本开支占收入比重达 53%，连续三年提高。随着半导体景气度持续上行，产能紧缺促使半导体制造厂商加大资本开支投入力度，加速扩产，全球半导体制造板块开启扩产周期。根据 Omdia 的数据，全球晶圆代工资本开支在 2021 年资本开支有望达到 354.8 亿美元，而收入预计为 667.4 亿美元，资本开支占收入比重达到 53%，该比例连续三年提高。

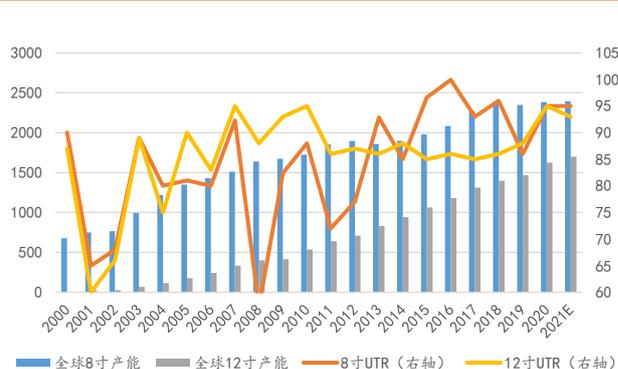
**半导体产能有望持续向大陆转移，大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。**需求端来看，受益于“万物互联+国产替代”，技术端受益于成熟制程工艺不断进步和先进制程工艺良率不断上升。晶圆代工作为产业链上游环节，充分受益于 5G 催生的以 AIoT 为代表的新应用的广泛普及。根据 SIA 数据，中国大陆半导体产能占全球比重 2020 年约 15%，2030 年约 24%，中国大陆有望成为未来 10 年全球半导体产能主要扩产区域，半导体产业有望持续向中国大陆转移。进而我们判断，未来 10 年中国大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球平均。

图 2：全球晶圆代工资本开支及收入（十亿美元）

图 3：全球晶圆代工产能及产能（kwpm）利用率（%）

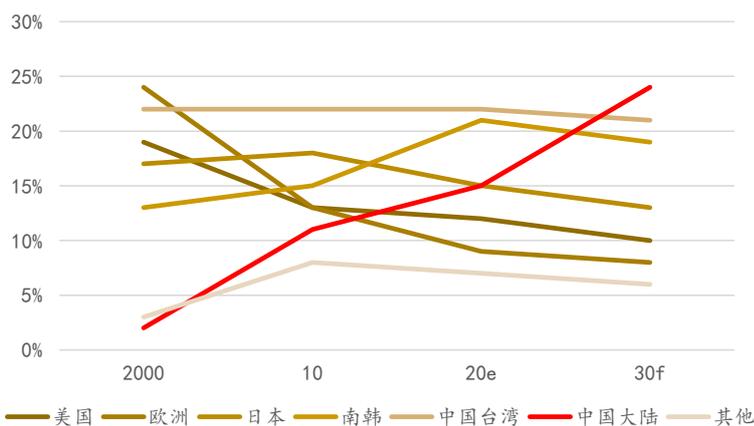


资料来源: Omdia, 天风证券研究所



资料来源: Omdia, 天风证券研究所

图 4: SIA 预计中国大陆 2030 年半导体产能占全球 21%



资料来源: SIA, 天风证券研究所

表 1: 部分本土半导体制造企业近期动态

公司	近期动态
晶合集成	公司于 2021 年 5 月 11 日递交招股书, 拟融资 120 亿用于 12 寸晶圆制造厂建设, 总投资额预计 165 亿元。
合肥长鑫	公司于 2020 年 12 月完成 156 亿融资, 投资方包括“大基金”二期、安徽国资、兆易创新、小米长江等, 根据《科创板日报》2021 年 3 月 1 日报道, 公司拟启动新一轮百亿级融资, 规模或超前期。
长江存储	日经新闻 2021 年 5 月 5 日报道, 长江存储计划在下半年让内存产量增长两倍至每月 10 万片。若以芯片片数计算, 全球 NAND flash 市场占有率将增至 7%。
闻泰科技	闻泰科技安世半导体位于上海临港的 12 寸晶圆厂已于 2021 年 1 月破土动工, 预计将于 2022 年 8 月投产, 产能预计将达到每年 40 万片。
华虹半导体	华虹无锡 12 寸厂产能迅速扩大, 4 月起 4 万片/月, 预计 2021 年年底达到 6.5 万片/月, 2022 年年中达到 8 万片/月, 公司计划向银团借款 8 亿美金用于扩产
中芯国际	公司计划建设中芯京城, 总投资约为 497 亿元人民币, 将分两期建设, 一期项目计划于 2024 年完工, 建成后将达成每月约 10 万片 12 英寸晶圆产能。2021 年 3 月 17 日公告计划投资 23.5 亿美元与深圳重投集团等合资建设月产能为 4 万片/月的 12 寸晶圆厂, 预估 2022 年开始生产。
华润微	华润微电子将在重庆西永微电园投资约 100 亿元建设 12 英寸功率半导体晶圆生产线, 主要生产 MOSFET、IGBT、电源管理芯片等功率半导体产品, 公司 12 寸产线 2021 年属于建设期, 预计在 2022 年可以实现产能贡献
士兰微	2021 年 5 月 11 日, 公司公告参股公司士兰集科于近日启动了第一条 12 英寸芯片生产线“新增年产 24 万片 12 英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目”, 该项目于 5 月 11 日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》, 总投资 20 亿元, 实施周期 2 年。

资料来源: 华润微公司公告、士兰微公司公告、中芯国际公司公告、闻泰科技公司官网、日经、华虹半导体 1Q21 业绩会、IT 之家、科创板日报、晶合集成招股说明书、天风证券研究所

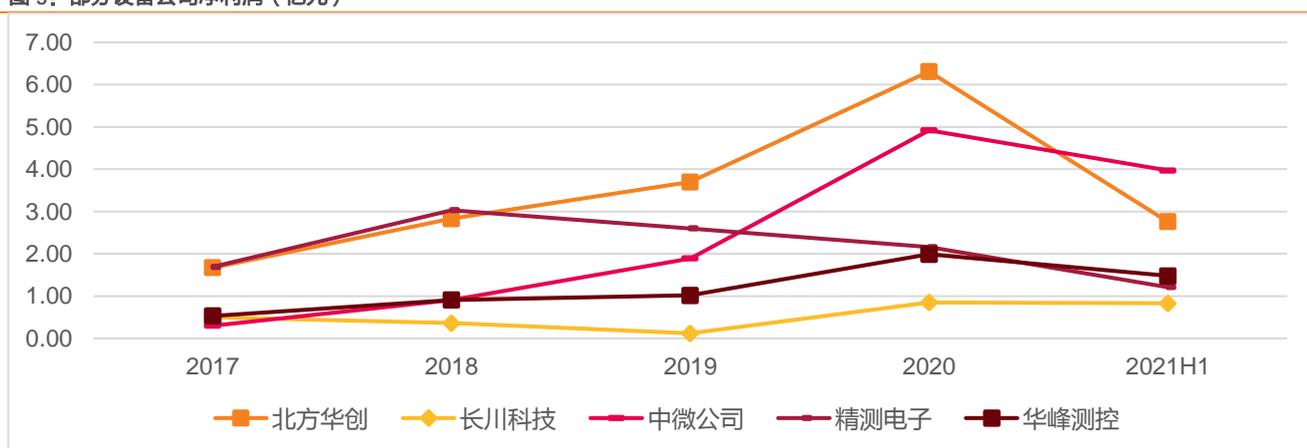
贸易摩擦背景下, 中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。在中美贸易摩擦背景下, 半导体全产业链国产替代的需求日益迫切, “原材料国产占比”的提高将为本土半导体企业提供周期以外的成长动能。考虑到目前大部分 A 股半导体公司所处产业环节国产替代率仍低, 预计“国产替代”仍是 A 股半导体未来几年的主线逻辑, 从下游到上

游，沿着设计-封测-制造-设备材料-设备零部件，国产替代逐步推进，本土半导体企业成长潜力较大。

**制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，我们判断半导体设备材料板块有预期上修空间。**当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。

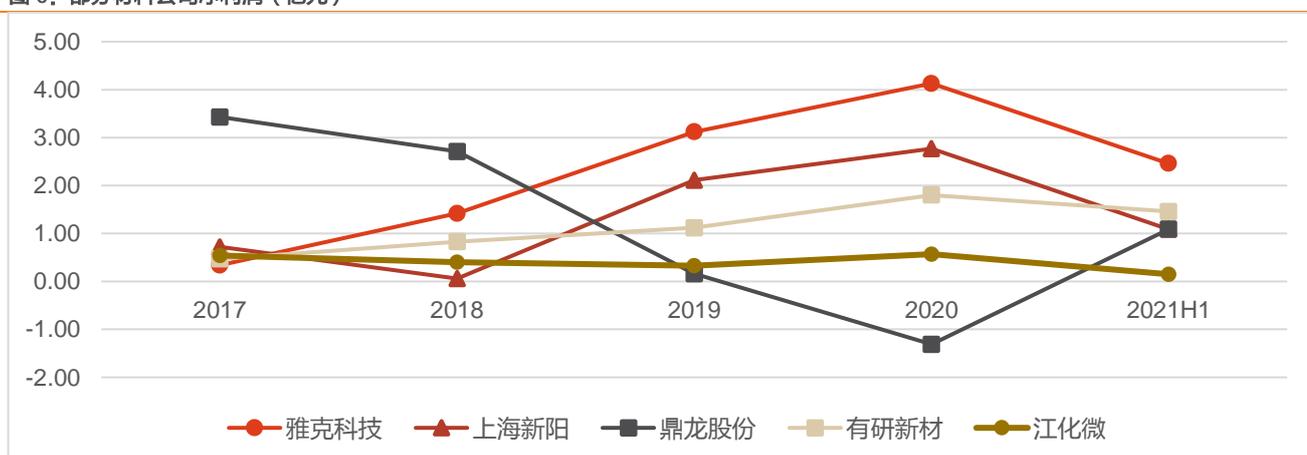
**设备材料板块业绩上修，各厂商半年报预期亮眼。**设备材料龙头皆发布半年度报告及半年度业绩预增公告。北方华创发布 2021 年半年度业绩预告，公司 2021 年半年度预计实现净利润为 2.76-3.31 亿元，同比增长 50-80%。长川科技预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 0.83-0.95 亿元，较去年同期增长 214.63% - 260.11%，扣非净利润预计为 0.66-0.78 亿元。雅克科技 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，较上年同期增长 14.72%，扣非净利润为 2.04 亿元，同比增长 31.46%。上海新阳 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.08 亿元，同比增长 316.82%。扣非净利润为 0.44 亿元，同比增长 76.42%。中微公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.97 亿元，同比增长 233.17%。扣非净利润 0.61 亿元，同比增长 53.35%。精测电子 2021 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 1.46 亿元，同比增加 203.43%。扣非净利润为 1.33 亿元，同比增长 229.49%。华峰测控 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，同比增加 66.02%。扣非净利润为 1.44 亿元，同比增加 90.76%。有研新材 2021 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 1.42 亿元，同比增加 113.57%，扣非净利润为 1.07 亿元，同比增加 173%。

图 5：部分设备公司净利润（亿元）



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 6：部分材料公司净利润（亿元）



资料来源：Wind、天风证券研究所

## 1.2. 东南亚疫情尚未控制，MOSFET、封测产能紧缺进一步增加

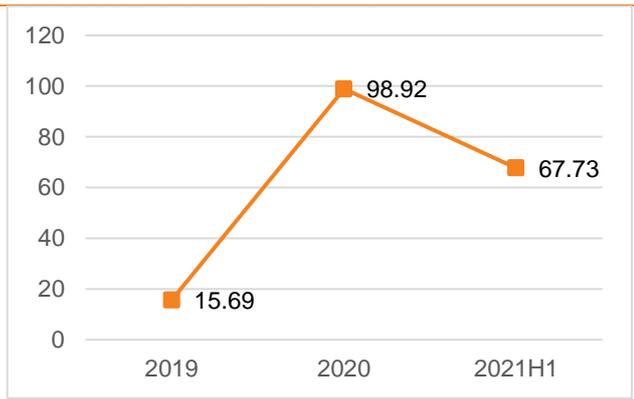
1. 东南亚新冠肺炎疫情蔓延，MOSFET 恐因产能排挤而缺货到明年，汽车行业尤为显著。包括菲律宾、马来西亚、越南等国持续维持封城禁令。虽然当地政府未要求半导体厂完全停工，但随着疫情急剧升温，确诊人数大幅攀升，当地半导体厂营运持续降载，不时传出因员工确诊而被要求停工数日消息。国际 IDM 厂因应疫情进行产能乾坤大挪移并优先支援车用，金氧半场效晶体管（MOSFET）恐因产能排挤而缺货到明年。全球芯片巨头、意法半导体位于马来西亚的一个工厂出现集体感染，工厂生产多次被迫中断，由此导致的芯片供应短缺问题已经传导至汽车行业。

MOSFET 下半年续迎缺货涨价潮，国内 MOSFET 厂或迎来新一波涨价/转单效应。5G、自驾车及医疗用等终端需求持续大增，使 MOSFET 整体需求至少出现倍数成长，在当前全球 IDM 大厂产能全面吃紧效应下，供应链传出，IDM 厂交期已经延长到 2022 年，且长约客户下半年再涨双位数水平，急单客户报价更达到 30~50%，显示 MOSFET 下半年续迎缺货涨价潮。国际 IDM 厂今年以来因 3C 应用 MOSFET 供货不足已多次宣布涨价，包括杰力、大中、尼克松、富鼎等台厂陆续跟进，下半年受惠于价格续涨及转单效应更为明确，预期将对中国台湾及国内 MOSFET 厂带来新一波转单效应。

国内功率器件大厂高景气度下优化产品结构，着重发展高利润汽车应用高压 MOSFET，毛利率持续提升。国内功率器件大厂如闻泰、士兰微等都开始削减用于消费电子应用的低压 MOSFET 产量，以便于将部分 8 吋产能转生产利润丰厚的汽车应用的高压 MOSFET。

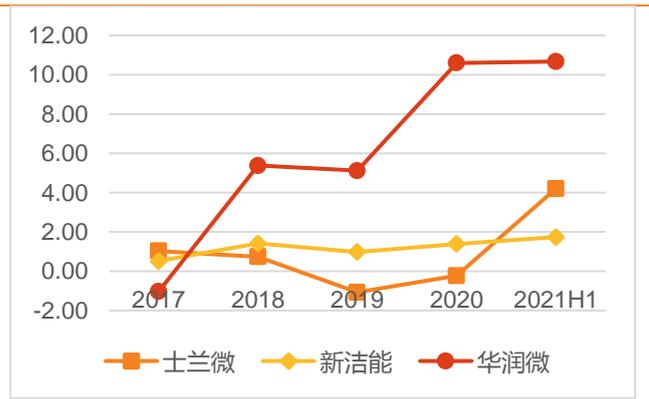
功率器件头部业绩上修，各厂商半年报亮眼。闻泰科技发布 2021 年半年度报告，公司半导体板块 2021 年半年度实现业务收入为 63.73 亿元，同比增长 53.25%。实现净利润为 9.39 亿元，同比增长 234.52%。士兰微发布 2021 年半年度报告，公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 4.3 亿元，同比增长 1306.52%，扣非净利润为 4.0 亿元。同比增长 17998.07%。新洁能 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，同比增长 215.29%，实现扣非净利润 1.69 亿元，同比增长 219.96%、华润微 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 0.11 亿元，同比增长 164.86%，实现扣非净利润 0.10 亿元，同比增长 194.43%。

图 7：闻泰科技半导体部分营业收入（亿元）



资料来源：Wind、天风证券研究所

图 8：功率器件公司净利润（亿元）



资料来源：Wind、天风证券研究所

2. “半导体封测重镇”马来西亚疫情反弹，芯片交货时间再度延长。马来西亚是全球半导体产业的重要组成部分，半导体封装测试产能占到全球的 13%。全球芯片巨头、意法半导体位于马来西亚的一个工厂出现集体感染，工厂生产多次被迫中断，由此导致的芯片供应短缺问题已经传导至汽车行业。

图 9：马来西亚疫情趋势图



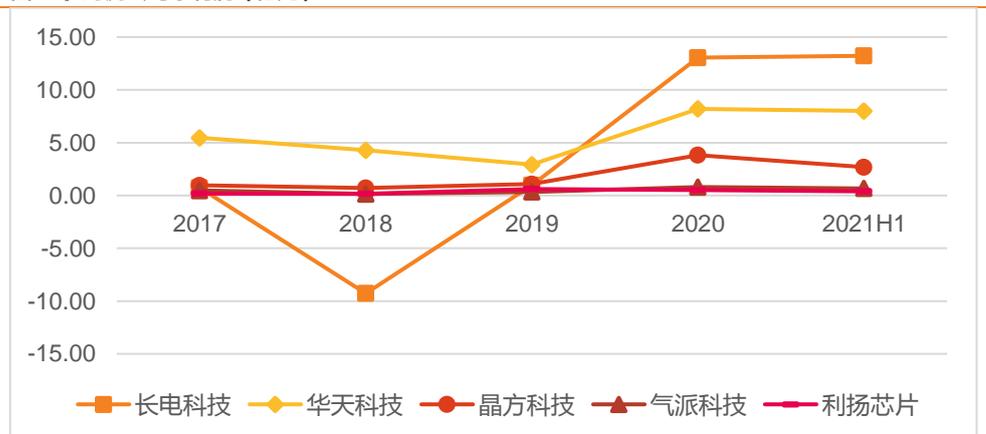
资料来源：Wind、天风证券研究所

**受马来西亚疫情影响下，全球封测产能缺口进一步拉大。**自去年下半年开启的晶圆代工产能供应不的状况，也传导至后端的半导体封测，再加上下游新能源车/5G 为代表的新需求创造成长动能，封测行业已然自去年四季度起景气度回升，产能供不应求芯片市场供不应求，叠加马来西亚疫情导致部分半导体企业生产中进一步增加封测产能缺口。

**马来西亚疫情预期转单回大陆，国内封测龙头成为潜在受益标的。**封测需求旺盛下我们预计马来西亚封测产能减少将转单回大陆，我国封测龙头长电科技、通富微电等目前产能较满，逻辑上利好，转单回大陆后可能会导致以上公司再发涨价函。

**封测板块业绩上修，各厂商半年报预期亮眼。**近期，四大封测厂及第三方测试厂龙头皆发布半年度报告及半年度业绩预增公告。长电科技发布 2021 年半年度报告，公司 2021 年半年度实现净利润为 13.2 亿元，同比增长 260.97%。扣非净利润为 9.39 亿元，同比增长 217.62%。通富微电预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 3.7-4.2 亿元，较去年同期增长 232.00% - 276.87%。华天科技 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 5.7-6.3 亿元，较上年同期增长：113.50% - 135.98%。晶方科技 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.68 亿元，同比增长 71.66%。扣非净利润为 2.37 亿元，同比增长 83.97%。气派科技 2021 年半年度实现营业收入 3.66 亿元，同比增长 65.58%。归属于母公司所有者的净利润 0.67 亿元，同比增长 150.56%。利扬芯片 2021 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 0.40 亿元，同比增加 47.1%。扣非净利润为 0.36 亿元，同比增长 37.23%。

图 10：封测公司净利润（亿元）



资料来源：Wind、天风证券研究所

**下游应用多点开花，智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加。**AIoT 进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长，2021 年半导体价值量有望达到 2500 亿人民币；汽车电子所展现的颠覆性趋势不可小觑，随着 AIOT 和新能源汽车的加速渗透，龙头企业的纷纷布局入场，汽车半导体的价值和量有望同步升级。2025 年新能源汽车销量有望突破 500 万辆，2030 年，汽车电子在整车中成本

占比有望从 2000 年的 18% 增加到 45%；5G 智能机占比提升带来半导体价值量大幅提升，5G 智能机相关零组件如射频、摄像头有望持续迭代升级。下游应用开启的长景气周期下预计封测厂商将持续收益。

后摩尔时代先进封装有望改道芯片业，头部封测厂积极布局先进封装往前道融合，同时国内产线的建设带动封测增量 EPS。后摩尔时代，封测企业正在向方案解决商的角色转变，地位也会被重新定义和架构。随着芯片工艺发展遇到了瓶颈，整体系统性能的提升成为关注的重点，未来的封测企业不再是简单的芯片封装和测试，而会转变为方案解决商。同时晶圆厂扩张带来的潜在增单效应对于封装厂来说提升行业天花板的上限带动 EPS 增量，全球晶圆代工资本开支占收入比重达 53%，连续三年提高，中芯华虹扩产趋势明确，预计中国大陆 2030 年半导体占比全球 21%。

## 2. 周观点

**看好市场上修全年预期。**高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，全年利润预期有望好于前期预测，景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。站在二季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期，进而带来相关股票的机会。

**半导体制造：一季度制造产能紧缺，未来 5 年持续扩产，彰显成长性。**涨价+UTR 提升+产品结构优化，一季度半导体制造板块毛利率环比提升。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来 5 年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大，战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注：**中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华润微/士兰微**

**IC 设计：一季度淡季不淡，关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。**一季度淡季不淡，IC 设计板块收入同比增 70%，毛利率和净利率环比均有提高。我们看好缺货涨价在二季度的持续性。关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。建议关注：**晶晨股份/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/中颖电子/兆易创新/富瀚微/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/紫光国微/斯达半导/新洁能**

**半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速。**一季度 A 股半导体设备材料板块收入增速环比提至 68%，材料板块毛利率提升，设备板块费用率下降，设备材料归母净利率均环比提高。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力较大。建议关注：**北方华创/雅克科技/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材/至纯科技/正帆科技**

## 3. 本周半导体行情回顾

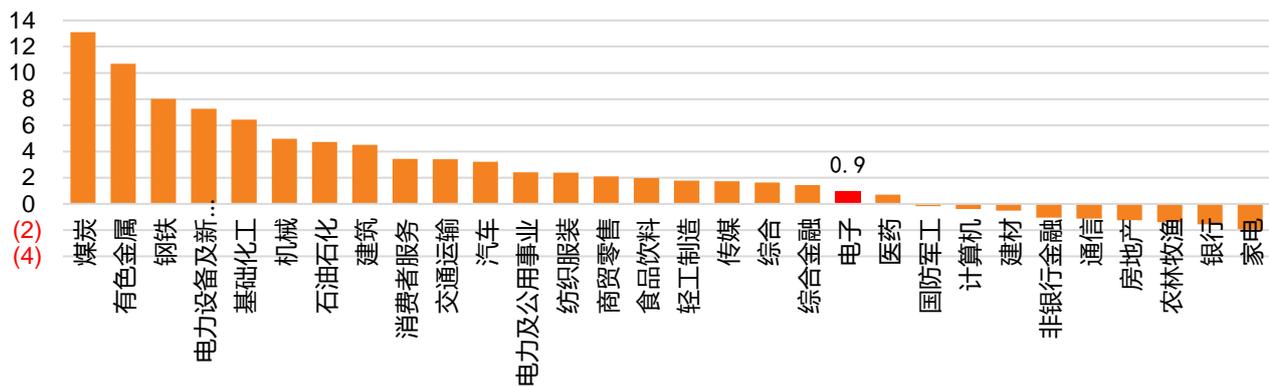
**本周半导体行情跑输主要指数。**本周申万半导体行业指数上涨 1.41%，同期创业板指数上涨 2.01%，上证综指上涨 2.77%，深证综指上涨 1.29%，中小板指上涨 2.35%，万得全 A 上涨 2.44%。半导体行业指数跑输主要指数。

表 2：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	2.01	-0.60
上证综合指数	2.77	-1.36
深证综合指数	1.29	0.12
中小板指数	2.35	-0.94
万得全 A	2.44	-1.03
半导体 (申万)	1.41	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

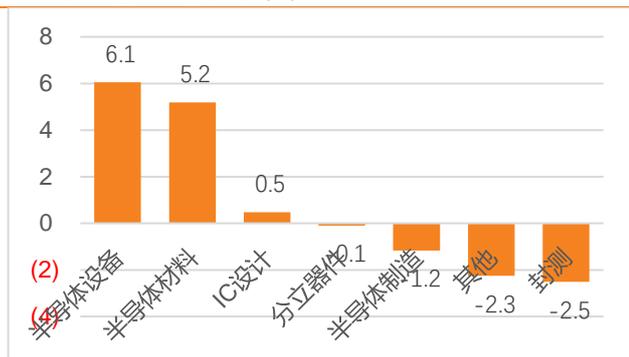
图 11：本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

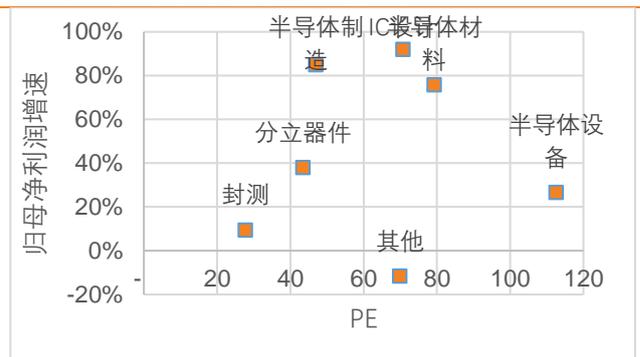
**半导体设备板块涨幅居前，一如我们此前的判断。**细分板块中，半导体设备板块本周上涨 6.1%，半导体材料板块本周上涨 5.2%，IC 设计板块本周上涨 0.5%，其他板块本周下跌 2.3%，封测板块本周下跌 2.5%，分立器件板块本周下跌 0.1%，半导体制造板块本周下跌 1.2%。**天风电子团队持续看好半导体设备材料板块的机会**，5 月 24 日报告《后摩尔时代，国产半导体设备材料有预期上修空间》中明确提出“当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。”6 月 16 日报告《持续看好国产半导体设备材料》重申观点，目前我们持续看好设备材料板块。

图 12: 本周子板块涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 13: 半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源: Wind, 天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：隆华科技、光华科技、凯盛科技、巨化股份、正帆科技、景嘉微、新莱应材、高测股份、石英股份、海陆重工。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：鸿远电子、机器人、康强电子、思瑞浦、力合微、火炬电子、安集科技、东软载波、寒武纪、金宏气体。

表 3: 本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅
隆华科技	36%	鸿远电子	-17.4%
光华科技	35%	机器人	-15.4%
凯盛科技	35%	康强电子	-13.7%
巨化股份	34%	思瑞浦	-10.3%
正帆科技	33%	力合微	-9.9%
景嘉微	30%	火炬电子	-9.9%
新莱应材	30%	安集科技	-8.7%
高测股份	26%	东软载波	-8.6%

石英股份	25%	寒武纪	-8.5%
海陆重工	23%	金宏气体	-8.3%

资料来源: Wind, 天风证券研究所

## 4. 本周重点公司公告

### 【卓胜微 300782.SZ】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示, 公司完成营业总收入 2,359,358,476.19 元, 同比增长 136.48%; 完成归属于上市公司股东的净利润 1,014,448,560.09 元, 同比增长 187.37%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 993,954,826.86 元, 同比增长 192.42%。报告期末, 公司资产总额 6,986,444,935.95 元, 同比增长 126.08%; 归属于上市公司股东的净资产 6,453,516,469.91 元, 同比增长 142.63%。

公司报告期业绩较上年相比大幅增长主要原因为: 一方面, 5G 通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长, 公司产品在客户端持续渗透。另一方面, 相较于去年同期, 公司产品类型实现从分立器件向射频模组的跨越, 凭借产品的高性能指标及交付稳定性等综合优势, 适用于 5G 新频段的接收端射频模组产品需求持续攀升。

### 【\*ST 盈方 000670.SZ】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示, 公司完成营业总收入 1,363,212,674.24 元, 同比增长 151,223.70%; 完成归属于上市公司股东的净利润 6,096,857.63 元, 同比增长 182.83%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,031,975.70 元, 同比增长 180.62%。报告期末, 公司资产总额 1,313,001,130.50 元, 同比下降 10.58%; 归属于上市公司股东的净资产 23,215,509.89 元, 同比增长 47.22%。

公司于 2020 年 9 月 25 日完成了华信科 51%的股权及 WORLD STYLE51%的股份的购买, 新增了电子元器件分销业务, 2021 年半年度报告期相关数据含华信科及 WS 合并数据, 上年同期未含华信科及 WS 合并数据。

### 【有研新材 600206.SH】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示, 公司完成营业总收入 7,628,356,774.36 元, 同比增长 49.88%; 完成归属于上市公司股东的净利润 141,969,229.61 元, 同比增长 113.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,728,195.87 元, 同比增长 173%。报告期末, 公司资产总额 4,652,078,484.60 元, 同比增长 9.15%; 归属于上市公司股东的净资产 3,307,848,934.80 元, 同比增长 1.76%。

报告期内, 公司营业收入变动的原因为公司各板块主要产品较同期均有所提升, 其中电板块业务增幅较大。公司各板块以市场化眼光深度分析、布局各板块业务, 通过多重方式增进与客户交流, 增加客户粘性。电板块, 紧抓市场机遇, 薄膜材料销售业绩大幅增长, 上半年销售收入、毛利较去年同期增长 80%。铂族金属业务销售额同比增加 40%。

### 【气派科技 688216.SH】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示, 公司完成营业总收入 366,218,391.80 元, 同比增长 65.58%; 完成归属于上市公司股东的净利润 68,039,076.95 元, 同比增长 150.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,887,585.39 元, 同比增长 164.55%。报告期末, 公司资产总额 1,598,549,775.60 元, 同比增长 53.38%; 归属于上市公司股东的净资产 951,986,635.23 元, 同比增长 74.45%。

报告期内，公司紧抓行业机遇，不断开拓市场，同时进行产品结构调整，导入优质客户，减少低毛利率产品占比，不断加大先进封装产品的研发及导入，深入推进精益生产管理，持续提升公司的核心竞争力，实现了公司主营业务稳定增长。

#### 【康强电子 002119.SZ】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,056,459,539.52 元，同比增长 61.16%；完成归属于上市公司股东的净利润 71,021,286.85 元，同比增长 36.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,153,887.48 元，同比增长 84.74%。报告期末，公司资产总额 2,045,810,586.87 元，同比增长 11.85%；归属于上市公司股东的净资产 1,032,465,025.16 元，同比增长 6.31%。

2021 年上半年公司营业收入增长的主要原因系市场需求增加及原材料涨价导致产品涨价的因素。

#### 【中微公司 688012.SH】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,338,627,684.43 元，同比增长 36.82%；完成归属于上市公司股东的净利润 396,632,306.55 元，同比增长 233.17%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,615,169.40 元，同比增长 53.35%。报告期末，公司资产总额 14,449,604,643.04 元，同比增长 149.09%；归属于上市公司股东的净资产 13,020,519,750.43 元，同比增长 198.02%。

报告期内，公司在研发创新、知识产权体系建设、生产经营、外延式生长等方面取得了积极成果。公司上半年营业收入增长主要受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约 233.17%，主要原因是：（1）扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加约 0.21 亿元；（2）本期产生公允价值变动损益 1.71 亿元。

#### 【紫光国微 002049.SZ】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 2,292,379,386.29 元，同比增长 56.54%；完成归属于上市公司股东的净利润 875,552,952.92 元，同比增长 117.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 801,731,437.44 元，同比增长 125.21%。报告期末，公司资产总额 10,069,490,153.94 元，同比增长 32.01%；归属于上市公司股东的净资产 6,165,885,010.18 元，同比增长 24.26%。

报告期内，公司所处各细分行业均呈现高景气度，下游需求旺盛，主要业务板块订单饱满，经济效益显著。其中，特种集成电路持续深耕产业链，各产品系列的研发工作和市场销售均有亮眼的表现，优质大客户的数量继续大幅增加，保持了营收规模和利润的高速增长。智能安全芯片业务积极拓展创新市场，整体业务发展态势良好，行业地位进一步巩固。

#### 【华亚智能 003043.SZ】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 232,846,607.00 元，同比增长 34.59%；完成归属于上市公司股东的净利润 47,845,182.77 元，同比增长 27.52%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,479,705.69 元，同比增长 27.20%。报告期末，公司资产总额 909,553,242.45 元，同比增长 88.82%；归属于上市公司股东的净资产 796,365,759.21 元，同比增长 99.63%。

公司以半导体设备领域业务结构件产品为发展核心。在半导体设备领域结构件产品业务与客户开展深度合作，随着新客户及新产品的不断开发，半导体设备领域结构件产品收入稳步增长；公司在各业务领域不断承接新客户，带来新的收入增长点。

#### 【睿创微纳 688002.SH】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 870,222,866.48 元，同比增长 25.54%；完成归属于上市公司股东的净利润 318,901,315.98 元，同比增长 3.41%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,621,741.78 元，同比增长 5.44%。报告期末，公司资产总额 3,972,093,400.37 元，同比增长 12.06%；归属于上市公司股东的净资产 3,182,257,911.24 元，同比增长 8.65%。

报告期内，公司营业收入增长主要系报告期内公司持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场扩大销售，主营业务中的热成像机芯模组和热像仪整机产品产销量快速增加所致。

#### 【华峰测控 688200.SH】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 324,415,109.31 元，同比增长 76.26%；完成归属于上市公司股东的净利润 148,427,417.09 元，同比增长 66.02%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,690,591.80 元，同比增长 90.76%。报告期末，公司资产总额 2,502,497,665.71 元，同比增长 10.24%；归属于上市公司股东的净资产 2,263,672,542.65 元，同比增长 6.04%。

报告期内，公司抓住行业发展机遇，持续坚持高强度的研发投入，产品竞争力优势明显，生产经营高效，营业收入和净利润等财务指标均实现较大增长，因此每股收益等指标也大幅度提升，净资产收益率等指标比同比增加。

#### 【富瀚微 300613.SZ】

公司于 2021 年 8 月 26 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 717,753,294.05 元，同比增长 154.37%；完成归属于上市公司股东的净利润 138,708,347.66 元，同比增长 215.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,026,838.79 元，同比增长 215.39%。报告期末，公司资产总额 2,140,767,858.22 元，同比增长 47.17%；归属于上市公司股东的净资产 1,497,975,837.33 元，同比增长 12.19%。

下游市场需求旺盛，产品销售收入增加是公司营业收入加速增长的驱动因素。报告期内，公司所处细分市场下游需求呈现快速增长趋势，同时，公司以市场需求为导向，前瞻性地规划布局与持续大力研发为公司客户提供更丰富的产品选择，使公司产品的竞争力不断提升，核心技术成果转化效果显著，有效驱动公司业绩成长。

#### 【新洁能 605111.SH】

公司于 2021 年 8 月 26 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 677,150,208.31 元，同比增长 76.21%；完成归属于上市公司股东的净利润 174,476,187.56 元，同比增长 215.29%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 169,970,911.80 元，同比增长 219.96%。报告期末，公司资产总额 1,568,961,676.02 元，同比增长 12.19%；归属于上市公司股东的净资产 1,292,439,551.79 元，同比增长 11.42%。

2021 年上半年，受到疫情影响、电子元器件国产化加快、新兴应用领域兴起等因素的持续影响，功率半导体行业景气度日趋升高，上游产能日益紧张。围绕市场需求、客户需求以及行业发展趋势，公司积极进行研发升级与产品技术迭代；持续开发与维护供应链资源，争取更多的产能支持；同时，优化市场结构、客户结构及产品结构，开拓新兴市

场与开发重点客户，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。

### 【惠伦晶体 300460.SZ】

公司于 2021 年 8 月 26 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 333,212,329.77 元，同比增长 130.83%；完成归属于上市公司股东的净利润 88,065,242.54 元，同比增长 1,960.79%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,896,458.69 元，同比增长 4,785.93%。报告期末，公司资产总额 1,725,300,471.35 元，同比增长 63.24%；归属于上市公司股东的净资产 1,148,658,306.34 元，同比增长 107.68%。

总体来讲，2021 年上半年业绩是公司历年业绩最好的。受益于 5G 及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，公司经营战略的转变，以及下游客户结构进一步优化，公司电子元器件业务订单充足稳定，公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势。

### 【中晶科技 003026.SZ】

公司于 2021 年 8 月 26 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 184,675,428.08 元，同比增长 46.52%；完成归属于上市公司股东的净利润 72,862,406.27 元，同比增长 90.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,855,757.73 元，同比增长 88.21%。报告期末，公司资产总额 955,681,717.62 元，同比增长 13.23%；归属于上市公司股东的净资产 720,453,636.11 元，同比下降 3.60%。

报告期内，公司营业收入增长主要系半导体行业景气度提升，市场需求旺盛，订单增加，产能持续释放，从而导致营业收入相应增长

### 【派瑞股份 300831.SZ】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 71,068,791.11 元，同比下降 20.54%；完成归属于上市公司股东的净利润 11,389,461.15 元，同比下降 46.46%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,026,648.02 元，同比下降 28.11%。报告期末，公司资产总额 824,485,866.95 元，同比增长 1.61%；归属于上市公司股东的净资产 770,149,596.49 元，同比增长 1.50%。

公司营业收入和净利润的变动原因主要是：（1）本期在手合同依据客户项目进度执行，尚未到达交货验收时点的影响；（2）本期普通产品交付占比较多的影响；（3）获得政府上市奖励资金的差异影响。公司报告期内主营业务未发生重大变化，一直专注于电力半导体器件的研制和生产；经过多年的专注发展，公司在大功率、大直径的高等级晶闸管领域成为行业龙头，占据了领先的国内市场份额，并且储备了多种规格、多种应用场景的其他晶闸管品种，形成了较为完善的产品序列组合。

### 【南大光电 300346.SZ】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 44,278.81 万元，同比增长 69.14%；完成归属于上市公司股东的净利润 8,552.02 万元，同比下降 3.23%。考虑到上年同期出售参股公司股权确认的投资收益的一次性因素，主营利润的实际增长快速，上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,587.35 万元，同比增长 4,013.99%。报告期末，公司资产总额 2,892,445,407.54 元，同比增长 8.21%；归属于上市公司股东的净资产 1,404,152,007.23 元，同比增长 6.47%。

受行业景气和市场需求牵引，公司主要产品的产能扩大较快，销售回笼和利润增长进一步向好。报告期内，MO 源产品产销两旺，有毛利提升带动的净利润增长，又有通过提升 MO 源超纯化和超纯分析技术实现的第三代半导体领域的新应用市场增长。

### 【瑞芯微 603893.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,378,414,625.95 元，同比增长 104.50%；完成归属于上市公司股东的净利润 264,850,884.85 元，同比增长 184.70%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,430,598.80 元，同比增长 171.82%。报告期末，公司资产总额 2,899,432,203.37 元，同比增长 6.66%；归属于上市公司股东的净资产 2,374,114,681.35 元，同比增长 5.01%。

整体上看，2021 年上半年公司业绩增长主要得益于如下方面：（1）人工智能物联网设备、智能教育电子和智能家居以及办公会议设备等产品（例如智能音箱，扫地机器人、翻译笔）的需求增长带动公司业绩增长；（2）去年及今年一季度推出的机器视觉芯片 RV11XX、智能应用处理器 RK356X 等新产品的规模化量产，销售良好，进一步扩展公司客户群体和应用场景，并拉动公司业绩增长；（3）受上游供应商供应价格上涨影响，公司在 2021 年初对部分产品进行提价，维持产品的基本毛利率。

### 【太极实业 600667.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 10,228,467,186.42 元，同比增长 21.92%；完成归属于上市公司股东的净利润 402,929,402.45 元，同比增长 26.07%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 396,060,691.16 元，同比增长 28.77%。报告期末，公司资产总额 22,587,492,841.28 元，同比增长 5.36%；归属于上市公司股东的净资产 7,456,451,338.49 元，同比增长 0.47%。

公司在动能转换中善于谋势，发展势头保持良好；在深化改革中善于借势，管理势能逐步显现。面对百年未有之大变局，各下属公司坚持做好自己的事，走好自己的路，不断扩产能、提效益、调结构、优布局，运营效能实现优化升级。

### 【江丰电子 300666.SZ】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 723,341,918.15 元，同比增长 35.68%；完成归属于上市公司股东的净利润 60,635,889.26 元，同比增长 48.49%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,214,451.79 元，同比增长 12.46%。报告期末，公司资产总额 2,681,289,672.81 元，同比增长 13.06%；归属于上市公司股东的净资产 1,141,218,120.83 元，同比增长 5.95%。

在报告期内，公司把握机遇，充分利用技术、服务、市场等优势，在对现有客户加强渗透的基础上，同时拓展新客户，使得销售收入持续增长，新增重要客户订单。同时，国内半导体产业对国产化需求紧迫，对国产替代的进度也大大加快，公司受益于近年来装备和产线的不断加强和扩充，产品的加工制造能力得到了进一步提升，从而加强了在市场端的竞争力。

### 【阿石创 300706.SZ】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 241,070,312.29 元，同比增长 93.40%；完成归属于上市公司股东的净利润 6,019,980.31 元，同比增长 318.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,662,519.26 元，同比增长 174.57%。报告期末，公司资产总额 1,051,727,353.01 元，同比增长 3.89%；归属于上市公司股东的净资产 447,597,149.98 元，同比增长 1.05%。

报告期内公司营业收入增长主要系公司销量增长及非同一控制下合并导致收入增加所致。

**【帝科股份 300842.SZ】**

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,395,367,834.99 元，同比增长 179.38%；完成归属于上市公司股东的净利润 68,266,427.55 元，同比增长 41.38%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,303,645.32 元，同比增长 170.90%。报告期末，公司资产总额 2,053,536,095.27 元，同比增长 26.87%；归属于上市公司股东的净资产 903,272,231.78 元，同比增长 8.23%。

报告期内公司营业收入增长主要系本期公司积极把握下游需求增长的市场机遇，加大技术研发和市场开拓力度，出货量同比大幅增长，以及银点价格同比上涨，综合使得本期营业收入快速增长。

**【汇顶科技 603160.SH】**

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 2,909,876,707.49 元，同比下降 4.78%；完成归属于上市公司股东的净利润 420,502,458.17 元，同比下降 29.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,402,927.76 元，同比下降 49.96%。报告期末，公司资产总额 9,949,464,624.23 元，同比增长 0.62%；归属于上市公司股东的净资产 7,929,175,187.86 元，同比下降 1.34%。

公司整体财务状况良好，2021 年上半年因受新冠肺炎疫情及国际形势变化等因素的影响，上半年营业收入略有下降；因受市场竞争加剧、疫情等综合影响，毛利率的下降及研发费用的增加，导致 2021 年上半年净利润有所下降；截至 2021 年 6 月 30 日止的流动比率为 3.81 倍，展现公司良好的偿债能力；资产负债率为 20.31%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

**【力芯微 688601.SH】**

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 369,752,833.01 元，同比增长 64.78%；完成归属于上市公司股东的净利润 61,607,203.35 元，同比增长 105.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,769,171.41 元，同比增长 130.52%。报告期末，公司资产总额 1,050,685,249.13 元，同比增长 150.98%；归属于上市公司股东的净资产 897,117,436.74 元，同比增长 177.69%。

公司在与下游市场多家知名客户保持稳定、良好的合作关系的同时，产品结构进一步优化，随着下游市场需求持续旺盛，公司业绩实现了快速增长。

**【恒玄科技 688608.SH】**

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 733,404,487.50 元，同比增长 117.08%；完成归属于上市公司股东的净利润 189,085,865.38 元，同比增长 286.87%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,636,720.02 元，同比增长 312.04%。报告期末，公司资产总额 6,029,000,422.81 元，同比增长 4.59%；归属于上市公司股东的净资产 5,672,759,473.15 元，同比增长 3.22%。

报告期内，受益于 TWS 耳机市场的快速发展及公司技术和产品的竞争优势，公司营业收入较去年同期增长 117.08%，同时规模效应的稳步提升，使得净利润、每股收益等指标较去年同期有较大增长。

**【力合微 688589.SH】**

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入

138,994,212.04 元，同比增长 20.14%；完成归属于上市公司股东的净利润 16,197,194.97 元，同比增长 6.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,770,871.41 元，同比下降 24.73%。报告期末，公司资产总额 850,909,858.20 元，同比增长 5.67%；归属于上市公司股东的净资产 717,204,550.53 元，同比增长 0.17%。

公司营业收入同比上升主要系 2021 年上半年国内疫情得到有效控制，生产供货逐步恢复所致。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，同比下降 24.73%。主要系研发投入持续增加，运营规模扩大及 2021 年上半年国内疫情得到有效控制导致管理费用及销售费用增加所致。

### 【韦尔股份 603501.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 124.48 亿元，同比增长 54.77%，其中半导体设计业务收入实现 105.49 亿元，占比主营业务收入的比例为 85.07%，较上年同期增加了 53.07%；完成归属于上市公司股东的净利润 2,243,549,335.55 元，同比增长 126.60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,965,854,213.94 元，同比增长 111.90%。报告期末，公司资产总额 27,823,178,032.50 元，同比增长 22.85%；归属于上市公司股东的净资产 13,322,118,348.89 元，同比增长 18.54%。

通过公司各业务体系及产品线的整合，公司充分发挥了各业务体系的协同效应，使公司持续盈利能力得到了显著提升。

### 【芯海科技 688595.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 274,582,623.04 元，同比增长 72.26%；完成归属于上市公司股东的净利润 47,348,896.04 元，同比增长 4.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,732,667.76 元，同比增长 15.72%。报告期末，公司资产总额 1,014,264,649.13 元，同比下降 0.66%；归属于上市公司股东的净资产 889,008,226.82 元，同比增长 3.59%。

公司是全信号链集成电路设计企业，是国内上市企业中唯一一家模拟信号链和 MCU 双平台驱动的集成电路设计企业，也是少数拥有物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。报告期内，公司在产品研发和市场开拓上不断突破，行业地位得到进一步的提升。公司产品分为模拟信号链芯片、MCU 芯片、健康测量 AIOT 产品，2021 年上半年行业景气度高、需求持续旺盛，公司营收在各应用领域取得快速突破或保持快速增长。

### 【清溢光电 688138.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 227,573,063.49 元，同比下降 12.91%；完成归属于上市公司股东的净利润 20,704,048.31 元，同比下降 47.59%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,537,525.42 元，同比下降 57.90%。报告期末，公司资产总额 1,487,707,076.20 元，同比增长 4.40%；归属于上市公司股东的净资产 1,174,929,734.98 元，同比下降 0.28%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，一是本期子公司合肥清溢同比去年增加亏损 1204.97 万元，合肥清溢在二季度已正式投产，相应的折旧费用及运营成本增加，由于产能爬坡需要时间及磨合，第二季度产销规模尚较低，造成整个上半年出现亏损；二是母公司整体产销规模有所下滑，受新冠疫情影响，平板显示行业订单出现一定程度的下滑，虽然公司在半导体芯片行业的订单持续增长，但整体产销规模仍然有所下降，造成母公司利润也有所下滑。

### 【雅克科技 002409.SZ】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,803,307,079.57 元，同比增长 94.16%；完成归属于上市公司股东的净利润 242,089,370.55 元，同比增长 14.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,137,922.46 元，同比增长 31.46%。报告期末，公司资产总额 6,056,944,610.94 元，同比增长 2.25%；归属于上市公司股东的净资产 4,808,446,469.90 元，同比增长 2.03%。

报告期内，本公司营业收入增长主要原因为本报告期合并范围扩大，增加了子公司科特美，同时 LNG 业务与去年同期相比增长了 962.5%，阻燃剂业务增长了 36.63%，电子特气业务增长了 16.56%。

### 【芯源微 688037.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 350,908,038.29 元，同比增长 461.85%；完成归属于上市公司股东的净利润 35,069,938.75 元，同比增长 464.05%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,577,109.81 元。报告期末，公司资产总额 1,610,772,321.83 元，同比增长 31.53%；归属于上市公司股东的净资产 830,351,935.34 元，同比增长 3.98%。

公司营业收入较上年同期大幅增长，主要系半导体行业景气度持续向好，公司加大业务开拓力度，订单较上年同期有大幅增长，收入规模持续增长所致。

### 【澜起科技 688008.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 724,463,317.63 元，同比下降 33.51%；完成归属于上市公司股东的净利润 307,846,788.00 元，同比下降 48.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 177,747,195.31 元，同比下降 65.93%。报告期末，公司资产总额 8,620,199,775.97 元，同比增长 2.38%；归属于上市公司股东的净资产 8,127,785,775.19 元，同比增长 0.71%。

报告期内，公司营业收入较上年同期减少 33.51%，主要原因包括：（1）客户需求较去年同期有所下降；（2）DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，导致产品价格较去年同期有所下降；（3）公司产品以美元计价，美元兑人民币与去年同期相比有所贬值。随着 2021 年第二季度行业的复苏，在全体员工的共同努力下，公司业绩环比改善，2021 年第二季度实现营业收入 4.25 亿元，较第一季度环比增长 41.87%

### 【沪硅产业 688126.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 112,285.22 万元，同比增长 31.44%；完成归属于上市公司股东的净利润 10,529.16 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,652.63 万元。报告期末，公司资产总额 1,521,198.56 万元，同比增长 4.92%；归属于上市公司股东的净资产 999,093.78 万元，同比增长 5.80%。

报告期内，公司营业收入同比增长 31.44%，主要系因半导体市场需求旺盛及公司产能攀升，产量大幅增加所致，公司 200mm 及 300mm 硅片业务收入均有所增长。归属于上市公司股东净利润由较上年同期增加 18,788.58 万元，且转为正数，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损大幅减少，主要系因公司营业收入增长及毛利率提高所致。

### 【中芯国际 688981.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 16,090,387 千元，同比增长 22.3%；完成归属于上市公司股东的净利润 5,241,321 千元，同比增长 278.1%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,339,104 千元，同比增长 331.6%。报告期末，公司资产总额 207,729,432 千元，同比增长 1.5%；归属于上市公司股东的净资产 103,700,973 千元，同比增长 4.6%。

报告期内，公司上下付出加倍努力，持续创新，超额完成上半年收入目标。营业收入的增长主要是由于本期内销售晶圆的数量及平均售价上升所致。销售晶圆的数量由上年同期的 2.8 百万片约当 8 英寸晶圆增加 16.2%至本期内的 3.3 百万片约当 8 英寸晶圆。平均售价由上年同期 4,143 元增加至本期的 4,390 元。

#### 【晶方科技 603005.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 694,439,126.57 元，同比增长 52.63%；完成归属于上市公司股东的净利润 267,884,204.23 元，同比增长 71.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 237,446,418.50 元，同比增长 83.97%。报告期末，公司资产总额 4,274,178,278.05 元，同比增长 14.48%；归属于上市公司股东的净资产 3,547,311,978.03 元，同比增长 5.43%。

报告期内，公司营业收入以及归属于上市公司股东的净利润增加主要是由于公司封装出货量增加使得营收规模增加所致。

#### 【兆易创新 603986.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 3,640,884,058.16 元，同比增长 119.62%；完成归属于上市公司股东的净利润 785,707,095.74 元，同比增长 116.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 740,473,824.30 元，同比增长 137.60%。报告期末，公司资产总额 13,010,379,920.48 元，同比增长 11.10%；归属于上市公司股东的净资产 11,328,703,378.00 元，同比增长 5.94%。

公司营业收入同比增加约 19.83 亿元，其中存储器业务增加约 12.83 亿元，微控制器业务增加约 5.5 亿元，传感器业务增加约 1.48 亿元，主要是由于公司芯片产品市场需求增加，各业务产品线收入均有所增加。

#### 【上海贝岭 600171.SH】

公司于 2021 年 8 月 28 日公告《2021 年半年度报告》。公告显示，公司完成营业总收入 1,019,496,286.64 元，同比增长 87.19%；完成归属于上市公司股东的净利润 392,387,010.48 元，同比增长 337.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,368,925.62 元，同比增长 170.89%。报告期末，公司资产总额 4,328,115,697.71 元，同比增长 11.56%；归属于上市公司股东的净资产 3,613,135,073.57 元，同比增长 9.76%。

报告期内，公司集成电路产品主要布局在电源管理、智能计量及 SoC、EEPROM 存储器及功率器件等领域，公司 IC 产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控设备及各类通用的消费电子产品等领域。工控、通信、电力等行业为国产芯片提供的市场机会继续明显增加。

#### 【神工股份 688233.SH】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《持股 5%以上股东减持股份计划公告》。公告显示，截至本公告披露日，北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）以下简称“航天科工创投”直接持有锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或

“公司”) 21,941,705 股, 占公司总股本的 13.71%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份, 且已于 2021 年 2 月 22 日起解除限售并上市流通。

#### 【台基股份 300046.SZ】

公司于 2021 年 8 月 24 日公告《关于控股股东提前终止减持计划的公告》。公告显示, 控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司(以下简称“新仪元”)计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过其持有的本公司股份 2,365,313 股(即不超过本公司总股本比例 1%)。截至公告披露日, 新仪元已累计减持公司股份 1,720,000 股, 占公司总股本的 0.73%。

#### 【斯达半导 603290.SH】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。公告显示, 截至公告披露日, 嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“斯达半导”)股东浙江兴得利纺织有限公司(以下简称“兴得利”)持有本公司股份 25,312,900 股, 占公司总股本比例为 15.82%。兴得利计划通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,600,000 股, 占公司总股本的 1%。

#### 【芯原股份 688521.SH】

公司于 2021 年 8 月 25 日公告《关于拟与 Alphawave IP Inc.及北京智路资产管理有限公司签署 VAR 变更协议暨关联交易的公告》。公告显示, 芯原微电子(上海)股份有限公司与 Alphawave IP Inc.签署《Cooperation Framework Agreement》, Alphawave 指定公司作为其在指定地区(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区)的唯一销售合作伙伴, 公司在上述地区内拥有独家销售 Alphawave 的一系列多标准 SerDes IP 的权利, 同时成为 Alphawave 在全球范围内首选的 ASIC 合作伙伴。公司拟与 Alphawave、北京智路资产管理有限公司签署《VAR Variation Agreement》, 约定 Alphawave 相关 SerDes IP 主经销商的变更事宜。

#### 【芯海科技 688595.SH】

公司于 2021 年 8 月 26 日公告《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》。公告显示, 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 42,000.00 万元(含 42,000.00 万元), 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行。

#### 【捷捷微电 300623.SZ】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《捷捷微电关于子公司引入外部投资者增资的公告》。公告显示, 2021 年 8 月 26 日, 江苏捷捷微电子股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于子公司引入外部投资者增资的议案》, 根据公司的战略规划和经营发展需要, 拟引入外部投资者向子公司捷捷微电(南通)科技有限公司增资, 增资价格为每一元注册资本对应 1 元人民币, 增资金额不超过 20,000.00 万元。

假设按照最高金额 20,000.00 万元进行增资, 本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至 151,000 万元。公司持有捷捷南通科技 52.98%的股权, 捷捷南通科技为公司控股子公司。

## 【韦尔股份 603501.SH】

公司于 2021 年 8 月 27 日公告《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。公告显示，本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,160 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.34%。授予部分具体如下：

（一）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予不超过 800 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本计划草案公告日公司股本总额的 0.92%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在可行权日以行权价格购买 1 股韦尔股份股票的权利。

（二）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予不超过 360 万份限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本计划草案公告日公司股本总额的 0.41%。

本激励计划授予的股票期权的行权价格为 281.40 元/股，限制性股票的授予价格为 168.84 元/股。

## 5. 本周半导体重点新闻

### 5.1. IC 设计

**中天弘宇实现闪存技术颠覆性突破。**2021 年 8 月 22 日，中天弘宇在上海召开“自主创新先进存储技术”暨 90nm BCD 工艺平台上的 MTP IP 产品的发布会。据介绍，中天弘宇运用国际首创、国内自主原创的“二次电子倍增注入浮栅”的物理原理，在不改变原材料构成、工艺实现的条件下，对标传统的闪存系列产品，用自主原创的发明成果构造了全新的存储器底层技术体系，形成新型高性能存储器系列产品，属于颠覆性的先进存储技术。（半导体行业观察）

**工信部公示车联网身份认证和安全信任试点项目名单，紫光国微、龙芯中科等入列。**近日，工信部公示了车联网身份认证和安全信任试点项目名单。为尽快推进车联网网络安全保障能力建设，构建车联网身份认证和安全信任体系，工信部今年展开了针对车联网身份认证和安全信任试点工作。紫光国微、龙芯中科、方寸微电子等单位出现在了公示名单中。（集微网）

**上市大涨 214.3%，元禾璞华被投资企业普冉股份正式登陆科创板。**普冉股份在上交所科创板正式挂牌上市，公司证券代码为 688766，发行价格 148.9 元/股，截至 8 月 23 日，普冉股份股票报价 468 元/股，涨幅 214.3%，总市值达 169.6 亿元。资料显示，普冉股份主营业务包括非易失性存储器芯片的设计与销售，产品以 NOR Flash 和 EEPROM 两类非易失性存储器芯片为主，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。（集微网）

**唯捷创芯回复科创板首轮问询：具 5G 射频前端解决方案。**8 月 23 日，唯捷创芯在科创板上市首轮问询回复中表示，截止目前，其已具备为客户提供 5G 射频前端解决方案的能力，在 5G 新增频段的信号发射端和接收端均已具备相应的模组产品，是较早的推出 5G 射频前端解决方案的集成电路设计企业之一。唯捷创芯的 5G 射频前端解决方案产品已向小米、OPPO、vivo 等知名终端厂商的大批量销售和供应，在 5G 商用化的较早期即上市该等产品，有利于唯捷创芯在商用化进程不断深入的发展过程中享受行业的发展红利，提升唯捷创芯盈利能力。（摩尔芯闻）

## 5.2. 设备/材料

**强劲的半导体需求刺激全球芯片产能建设，利好半导体设备市场。**本周，SEMI 公布了最新半导体设备出货报告，2021 年 7 月，北美半导体设备制造商出货金额为 38.6 亿美元，环比 6 月的 36.9 亿美元提升 4.5%。由于芯片产能不足，晶圆厂数量呈现明显上升态势，据 SEMI 统计，全球半导体制造商将在今年年底前开始建设 19 座新晶圆厂，2022 年再另外建设 10 座。未来数年内，这 29 座晶圆厂的设备支出预计将超过 1400 亿美元。受此影响，中国半导体设备投资将迎来历史性机遇。（半导体行业观察）

**晶瑞电材：变更募集资金用途，拟新增 1200 吨/年的光刻胶产能。**鉴于市场因素，晶瑞电材拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能。晶瑞电材表示，受建设场地限制，拟将“8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目终止，将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额后的余额以向全资子公司眉山晶瑞进行财务资助的方式由其全部投入“年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目”。项目建设内容为光刻胶中间体 1,000 吨/年，光刻胶 1,200 吨/年。投资建设周期为自开工建设起 1 年。（集微网）

**盛美半导体发布首台应用于化合物半导体制造中晶圆级封装和电镀应用的电镀设备。**作为半导体制造与先进晶圆级封装领域中领先的设备供应商，盛美半导体设备近日发布了新产品——Ultra ECP GIII 电镀设备，以支持化合物半导体(SiC, GaN)和砷化镓(GaAs) 晶圆级封装。该系列设备还能将金 (Au) 镀到背面深孔工艺中，具有更好的均匀性和台阶覆盖率。Ultra ECP GIII 还配备了全自动平台，支持 6 英寸平边和 V 型槽晶圆的批量工艺，同时结合了盛美半导体的第二阳极和高速栅板技术，可实现最佳性能。（集微网）

**华峰测控：投入募集资金 3.8 亿元的天津基地已经完成建设并竣工验收。**8 月 25 日，华峰测控在业绩说明会上表示，天津基地已经完成建设并竣工验收，这个项目包括生产、研发和配套楼，已经投入募集资金 3.8 亿元，投入使用 2.6 万平米。目前布置了三条精益产线，包括两条 8200 产线，以及一条全新的 8300 精益产线，会进一步提高生产效率，释放产能。（集微网）

## 5.3. 代工/封测

**晶圆代工龙头台积电近日通知全数 IC 设计客户将扩大晶圆代工费用调涨范围，第 4 季起全线调涨。**据了解，台积电这次涨价以 12 纳米为分野，需求相对不紧张的 12 纳米以下先进制程第 4 季将调涨一成；需求紧缺的 12 纳米以上成熟制程则调涨两成。台积电 10 月起全面涨价，对产业链而言，由于台积电市占率超过五成，冲击范围更广，从 IC 设计客户到 PC、手机、电视、汽车、家电等各式终端产业，明年势必又将面临新一波成本上扬的压力的压力。（半导体行业观察）

**台媒：2021 年 4G 芯片的利润率有机会超过 5G 芯片。**随着移动芯片供应商越来越关注 5G 解决方案，由于缺乏晶圆代工厂足够的产能支持，4G 芯片供应持续萎缩，价格上涨。业内人士透露，今年下半年 4G 移动芯片价格将上涨，而 5G 芯片价格将下跌，今年全年 4G 芯片的利润率有机会超过 5G 芯片。（集微网）

**传西部数据将收购铠侠：交易金额或超 200 亿美元，合并后 NAND 市场份额有望超越三星。**8 月 26 日消息，据华尔街日报于当地时间 8 月 15 日报道称，据知情人士透露，美国

存储厂商西部数据计划收购日本存储厂商铠侠 (KIOXIA)，目前双方正在进行谈判，交易总金额或将超过 200 亿美元。如果两者合并，那么则意味着将拿下整个 NAND Flash 市场 33.4% 的份额，与排名第一的三星几乎持平，未来有望超越三星。(芯智讯)

**台媒：大陆封测厂正强化汽车芯片 QFN 封装能力。**业内消息人士称，包括长电科技、通富微电、华天科技在内的中国大陆封测厂正致力于提高汽车芯片 QFN (Quad Flat No-leads Package, 方形扁平无引脚封装) 封装能力。《电子时报》报道援引上述人士称，QFN 封装具有高性价比，可以取代 BGA 和 QFP，成为处理汽车芯片以及其他成熟芯片 (包括 IT 应用芯片) 的关键技术。(集微网)

**围绕第三代半导体产业打造，徐州凤凰湾集成电路产业园项目预计明年竣工。**据无线徐州报道，凤凰湾集成电路产业园项目正有序推进，预计 2022 年元月全部竣工。整个园区建成后，将助力徐州经开区打造亚洲最大的大硅片生产基地和全国重要的集成电路封测基地。(集微网)

#### 5.4. EDA/IP/其他

**思尔芯科创板 IPO 获受理，募资 10 亿元投建数字芯片 EDA 等项目。**8 月 24 日，上交所正式受理了上海国微思尔芯技术股份有限公司科创板 IPO 申请。招股书显示，思尔芯此次 IPO 拟募资 10 亿元，扣除发行费用后将投资于高性能数字芯片验证平台项目、国微思尔芯研发中心建设项目以及补充流动资金。其中，高性能数字芯片验证平台项目重点投资于近年来持续快速增长的数字芯片前端功能验证 EDA 工具链。(集微网)

**多地“十四五”规划出台，打造集成电路产业集群。**8 月 26 日，《浦东新区产业发展“十四五”规划》发布，显示“十四五”时期，浦东新区打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群。近日，江苏省政府办公厅正式印发《南京江北新区“十四五”发展规划》(以下简称：《规划》)，集成电路、生命健康两大千亿级地标产业集群加速崛起，数字产业发展成效初显，产业基础高级化、产业链现代化取得扎实成效。(集微网)

**芯动科技携高端 IP 闪耀全球 DesignCon 2021 大会。**在会上，芯动科技展示了全球最快的 GDDR6/6X 高速显存 IP，中国第一个自主 Chiplet、HBM2e/DDR5/LPDDR5、高速 PCIe5 等炙手可热的先进技术，和多种高速接口 IP 等多款拳头产品。芯动科技全新发布的 GDDR6/6X COMBO IP 是全球唯一的同类产品，其数据速率在业内首屈一指高达 21Gbps，在 256 位宽度下系统带宽超过 5Tb/秒，性能直追 HBM2e，但成本降低、性价比大大提升。(集微网)

**中天弘宇实现闪存技术颠覆性突破。**2021 年 8 月 22 日，中天弘宇在上海召开“自主原创先进存储技术”暨 90nm BCD 工艺平台上的 MTP IP 产品的发布会。据介绍，中天弘宇运用国际首创、国内自主原创的“二次电子倍增注入浮栅”的物理原理，在不改变原材料构成、工艺实现的前提下，对标传统的闪存系列产品，用自主原创的发明成果构造了全新的存储器底层技术体系，形成新型高性能存储器系列产品，属于颠覆性的先进存储技术。(半导体行业观察)

**工信部公示车联网身份认证和安全信任试点项目名单，紫光国微、龙芯中科等入列。**近日，工信部公示了车联网身份认证和安全信任试点项目名单。为尽快推进车联网网络安全保障能力建设，构建车联网身份认证和安全信任体系，工信部今年展开了针对车联网身份认证和安全信任试点工作。紫光国微、龙芯中科、方寸微电子等单位出现在了公示

名单中。(集微网)

**唯捷创芯回复科创板首轮问询：具 5G 射频前端解决方案。**8 月 23 日，唯捷创芯在科创板上市首轮问询回复中表示，截止目前，其已具备为客户提供 5G 射频前端解决方案的能力，在 5G 新增频段的信号发射端和接收端均已具备相应的模组产品，是较早的推出 5G 射频前端解决方案的集成电路设计企业之一。唯捷创芯的 5G 射频前端解决方案产品已向小米、OPPO、vivo 等知名终端厂商的大批量销售和供应，在 5G 商用化的较早期即上市该等产品，有利于唯捷创芯在商用化进程不断深入的发展过程中享受行业的发展红利，提升唯捷创芯盈利能力。(摩尔芯闻)

## 6. 风险提示：

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com